

Метод молекулярно-пучковой эпитаксии

Виноградов И.Д. Понур К.А. Шиков А.П.

Радиофизический факультет ННГУ, 430 группа

Научный руководитель: Лобанов Д.Н.

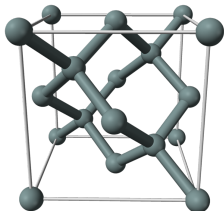
Нижний Новгород, 2018

Определение эпитаксии

Эпитаксия - это закономерное нарастание одного кристаллического материала на другой, т.е. ориентированный рост одного кристалла на поверхности другого.

Авто(гомо)эпитаксия

Материалы осаждаемого слоя и подложки идентичны, или имеют одинаковую кристаллическую решетку



Решетка германия и кремния

Гетероэпитаксия

Материалы осаждаемого слоя и подложки различны



Рутил на гематите

Область применения

Эпитаксия является одним из базовых процессов технологии изготовления полупроводниковых приборов и интегральных схем.

Преимущества эпитаксиальной технологии

- 1 Широкая область изменения уровня и профиля легирования
- 2 Возможность изменения типа проводимости выращиваемых эпитаксиальных слоев
- 3 Возможность проведения роста при температурах меньших, чем температура роста монокристалла
- 4 Возможность нанесения слоя как на большие площади, так и локально
- 5 Рост соединений со сложным, контролируемым составом

Методы эпитаксиального роста

Жидкофазная: Монокристаллические слои получают из контактирующей с подложкой перенасыщенных жидких растворов.

Недостатки: Сложности контроля параметров получаемых пленок, низкое качество.

Газофазная: Вещество, необходимое для роста поступает к подложке в составе химического соединения, с выделением при разложении вещества, необходимого для роста эпитаксиальной пленки.

Достоинства: Высокая скорость роста, высокая производительность.

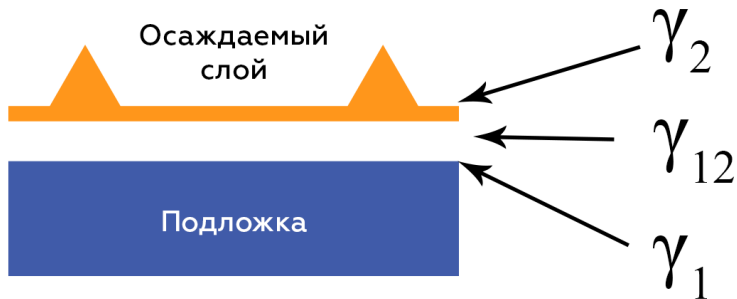
Недостатки: Токсичность, зависимость скорости роста от температуры подложки.

Молекулярно-лучевая: Хим. элементы, необходимые для роста поступают на подложку в виде молекулярных пучков этих элементов.

Достоинства: Возможность роста при пониженных температурах, лучший по сравнению с ГФЭ контроль над составом и толщиной слоев.

Недостатки: Низкая производительность, дороговизна(необходим

Механизмы гетероэпитаксиального роста

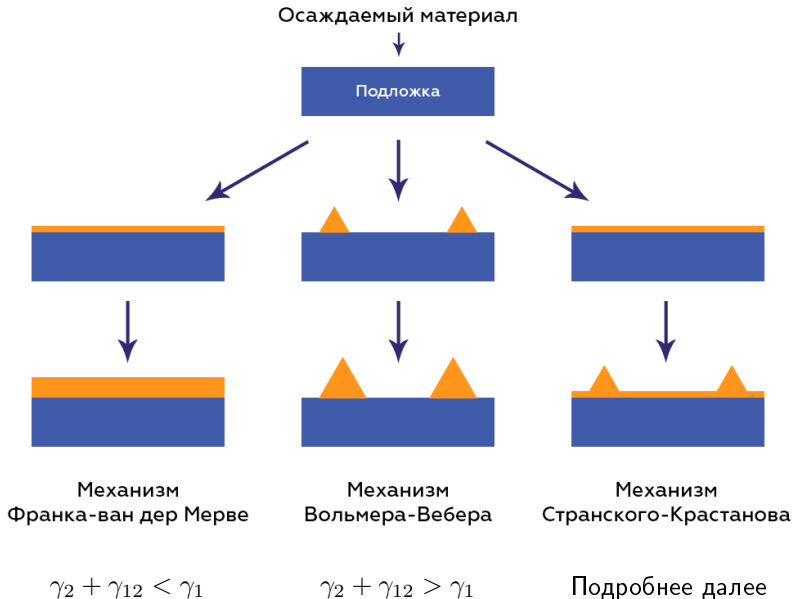


γ_1 - Энергия поверхности подложки

γ_{12} - Энергия границы раздела

γ_2 - Энергия поверхности осаждаемого материала

Механизмы гетероэпитаксиального роста



Механизм Странского-Крастанова

Осаждаемый материал



Механизм
Странского-Крастанова

Такой механизм имеет место, когда межатомное расстояние в решетке осаждаемого материала больше, чем в решетке подложки

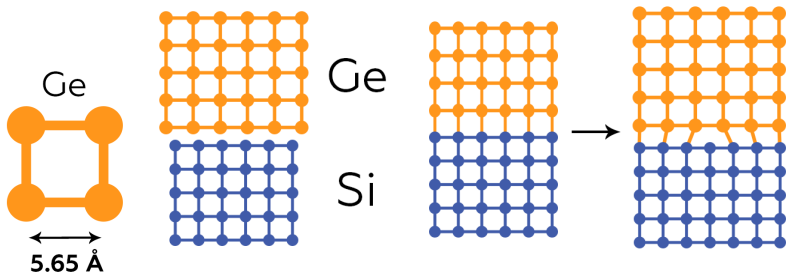
На начальных этапах выполняется

$$\gamma_2 + \gamma_{12} < \gamma_1$$

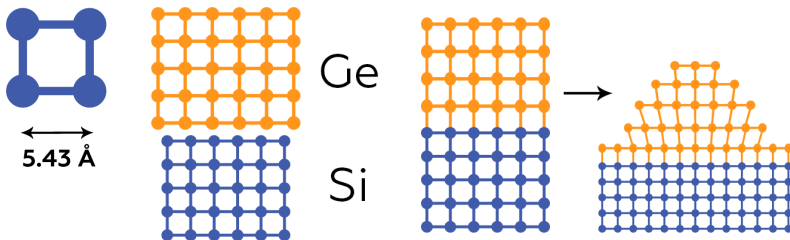
и образуется «смачивающий» слой, приводящий к уменьшению суммарной энергии системы. С определенной толщины энергия упругих напряжений увеличивается, увеличивая общую энергию системы, из-за чего происходит релаксация упругой энергии.

Механизмы релаксации упругих напряжений

«Классический» механизм дислокаций несоответствия

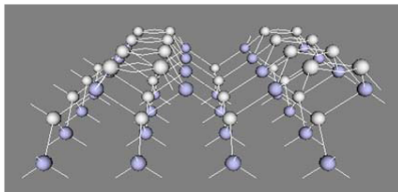
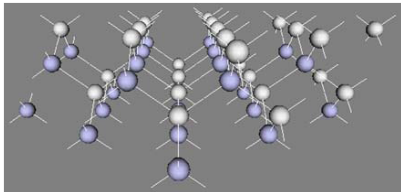


«Когерентный» рост по механизму Странского-Крастанова

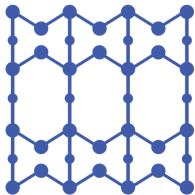


Реконструкция поверхности Si(001)

Уменьшение энергии системы за счет реконструкции на границе.



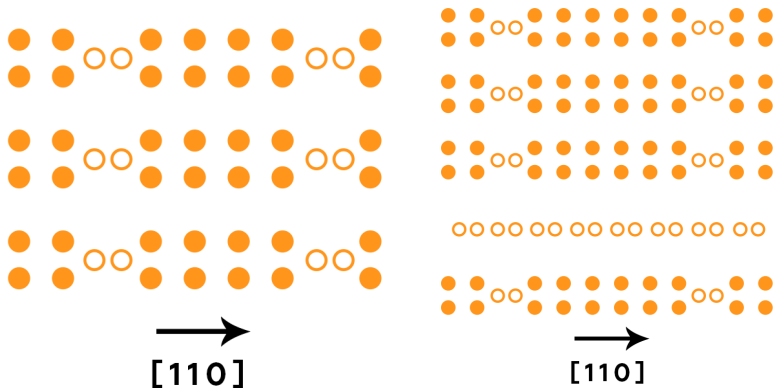
Димер - два близко расположенных атома Si



→
[110]

Образование димеров уменьшает энергию свободных связей поверхностных атомов. Димеры выстраиваются в цепочки, направление которых в каждом последующем слое меняется на 90°

Реконструкция поверхности Ge на Si(001)



При росте Ge на Si, в результате рассогласования параметров решетки, пленка Ge испытывает упругие напряжения сжатия. Эти напряжения приводят к образованию дивакансий в цепочках димеров.

Релаксация за счет образования 3D - структур

Образования Ge островков происходит возле углублений, образованных пересечениями отсутствующих димеров.

Толщина пленки при которой начинается формирование островков $d_{кр}$ для Ge, осаждаемого на Si(001), лежит в диапазоне 3-5 монослоев

Типы образуемых островков

Молекулярно-пучковая эпитаксия

Эксперимент

